

平成21年10月13日

各位

上場会社名 TOWA株式会社
 代表者 代表取締役社長 河原 洋逸
 (コード番号 6315)
 問合せ先責任者 取締役専務執行役員経営企画室長 西村 永和
 (TEL 075-692-0251)

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成21年5月14日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

(金額の単位:百万円)

平成22年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正(平成21年4月1日～平成21年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	4,800	△500	△500	△500	△19.99
今回発表予想(B)	5,800	△800	△950	△950	△37.98
増減額(B-A)	1,000	△300	△450	△450	
増減率(%)	20.8	—	—	—	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成21年3月期第2四半期)	8,527	△1,051	△1,116	△1,238	△49.49

平成22年3月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正(平成21年4月1日～平成21年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	4,800	△400	△400	△400	△15.99
今回発表予想(B)	5,600	△900	△850	△750	△29.98
増減額(B-A)	800	△500	△450	△350	
増減率(%)	16.7	—	—	—	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成21年3月期第2四半期)	8,186	△1,154	△1,239	△1,276	△51.02

修正の理由

半導体業界におきましては、アセンブリーハウスを始めとした各社半導体工場の稼働率は改善されたものの、当面の市場動向に不透明感があるため、半導体メーカーは設備投資に対する慎重な姿勢を崩しておりません。

このような状況のもと、当社グループでは、前期に市場投入した半導体樹脂封止装置の新製品「PMC」やLED樹脂封止装置「LCM」が好調に推移し、売上高は当初予想を上回る見通しとなりました。

しかしながら、少ない設備投資案件をめぐる受注獲得競争や、既存顧客の他社防衛対策等により、一部の案件では大幅に採算が悪化し、収益面では当初予想を下回る見込みであります。

これらの理由により、前回公表しました平成22年3月期の第2四半期累計期間の業績予想を上記のとおり修正いたします。なお、通期の業績予想につきましては、平成22年3月期第2四半期決算発表時(本年11月13日予定)に見直しを行う予定であります。

(注) 将来の事象に係る記述に関する注意事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

以上